

18.09.2019 - 22:49 Uhr

## TE Connectivity demonstriert anlässlich der ECOC 2019 400G-Verbindungs- und Kabelsatzlösungen

High-Speed-Lösungen verbessern die neuesten Gerätedesigns für Rechenzentren

Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Konnektivitätslösungen für Hochgeschwindigkeits-Computing- und Netzwerkanwendungen, gab heute bekannt, dass im Rahmen der ECOC-Konferenz 2019 (European Conference on Optical Communication) in Dublin, Irland, die von 23.-25. September stattfindet, ein umfassendes Programm an Hochleistungssteckverbindungen, Anschlüssen, Kabelsätzen und Stromversorgungslösungen vorgestellt wird. TE wird seine Innovationen an den folgenden Messeständen präsentieren:

- Ethernet Alliance (Halle 1, 134),
- OIF (Optical Internetworking Forum) (Halle 4, 441),
- COBO (Consortium for On-Board Optics) (Halle 1, 138)

Die Experten von TE werden an jedem dieser Standorte vertreten sein und für technische Gespräche zur Verfügung stehen, um zu erläutern, wie die Produkte von TE Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die Anwendungen der nächsten Generation unterstützen können.

Während der ECOC-Konferenz werden die 100G- und 400G-Produkte von TE am Stand von Ethernet Alliance, mit SFP56-, QSFP56-, OSFP- und QSFP-DD-Steckverbindern/Kabeln und QSFP-DD-zu-OSFP-Kabelbaugruppen sowie verschiedenen Arten von Breakoutkabeln, basierend auf 25G- und 50G-Einzelpaar-Signalisierung, aktiv demonstriert. Am OIF-Stand wird TE an aktiven Demonstrationen zur 112G-Einzelpaar-Signalisierung teilnehmen, mit einer OSFP-zu-QSFP-DD-Kabelbaugruppe, einem OSFP-basierten Leiterplattenkanal mit einer Länge von 266 mm (10,5 inch) sowie QSFP-DD-Anschluss und Käfig. Darüber hinaus wird TE seine internen Verkabelungssysteme vorstellen, die den Ersatz von PCB-Leiterbahnen im Inneren des Geräts ermöglichen. Auf dem COBO-Stand wird TE seinen 100 Gbit/s-fähigen Sliver-Steckverbinder demonstrieren, der als COBO-Industriestandard-Steckverbinder übernommen wurde. Diese Demonstration erfolgt im Rahmen einer Partnerschaft mit Credo.

Folgende TE-Produkte werden in diesen Präsentationen und Ausstellungen vorgestellt:

E/A-Anschlüsse: SFP56-, SFP-DD-, QSFP56-, OSFP- und QSFP-DD 400G-Verbindungen sowie COBO-Anschlüsse und Versionen dieser Steckverbindungen mit besserer thermischer Leistung.

Kupferkabelsätze: SFP56, SFP-DD, QSFP56, OSFP und QSFP-DD Kabelsätze, direkt anschließbar, einschließlich einer Demonstration der 800G-OSFP-Kabel. Darüber hinaus werden Sliver-Kabel (für SFF-TA-1002, GenZ) und STRADA-Whisper-Kabelsätze gezeigt.

Board-to-Board: STRADA Whisper, Z-PACK Slim UHD, Z-PACK HM-eZd+ Backplane-Steckverbinder und Backplane-Kabelsätze.

Socket: LGA 3647 (Socket P) und extra großes Array (XLA) 3800+ Positionsanschlüsse

Stromversorgung: Stromanschlüsse (für OCP), MULTI-BEAM-HD-Steckverbinder

Interne Verbindungen: Sliver-Verbindungen (SFF-TA-1002, GenZ, EDSFF, OCP NIC 3.0, DDIMM, COBO) und STRADA-Whisper-Steckverbinder in einem intern verkabelten System.

"Wir begrüßen die Gelegenheit, unsere Produkte bei der ECOC 19 live mit Ethernet Alliance, OIF und COBO vorstellen zu dürfen", sagt Nathan Tracy, Technologie für den Geschäftsbereich Daten und Geräte bei TE Connectivity, OIF-Präsident und Vorstandsmitglied bei Ethernet Alliance. "Unsere Mitgliedschaft in diesen Organisationen hilft TE dabei, jenen Kurs einzuhalten, den die Branche vorgibt, und ermöglicht uns bei TE, unsere weltweit führenden Technologien dazu zu nutzen, um die größten Herausforderungen der Branche zu meistern, beispielsweise im Bereich des Stromversorgungs- und Wärmemanagements oder zugunsten höherer Datengeschwindigkeiten bzw. für die Datenverarbeitung und -speicherung."

Informationen zu OIF

OIF fördert die branchenweite Zusammenarbeit und Weiterentwicklung durch den rechtzeitigen Ausbau der Interoperabilität. Die Live-Demonstrationen zur Interoperabilität anlässlich der ECOC 2019 werden Unternehmenslösungen enthalten, die für das globale Netzwerk von entscheidender Bedeutung sind, darunter 400ZR, IC-TROSA und Common Electrical I/O (CEI)-112G. Interoperabilitätsdemonstrationen werden vom 23. bis 25. September 2019 auf der ECOC in Dublin, Irland, am Stand 441 stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.oiforum.com/meetings-and-events/oif-ofc-2019>.

INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendes 14-Milliarden-USD-Unternehmen für Technologie und Fertigung, das sich darauf konzentriert, eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu schaffen. Seit mehr als 75 Jahren ermöglichen

unsere Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die sich in den härtesten Umgebungen bewährt haben, Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und in der Wohnumgebung. Mit 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, die mit Kunden in rund 140 Ländern zusammenarbeiten, stellt TE sicher, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT ("EVERY CONNECTION COUNTS"). Erfahren Sie mehr auf [www.te.com](http://www.te.com) und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

STRADA Whisper, Sliver, TE Connectivity, TE, TE Connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind von TE Connectivity Ltd. lizenzierte Marken oder Marken im Eigentum von TE Connectivity. Alle anderen erwähnten Produkte und Firmennamen sind gegebenenfalls Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Logo - [https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE\\_Connectivity\\_Logo.jpg](https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg)

Kontakt:

Lauren Way  
TE Connectivity  
717-986-7342  
[lauren.way@te.com](mailto:lauren.way@te.com)

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100060843/100832525> abgerufen werden.